

**EXBOND 1868H**

Room Temperature Curing Adhesive

March 2017

**产品描述**

专业用于散热器粘结，激光器封装以及电源供应器灌封等需要改善散热的元器件；单组份室温固化环保型硅胶。

**特性**

单组份，湿气固化；高导热；对各种基材无腐蚀且具有良好的粘接强度。

**胶液性能**

固化前性能	EXBOND 1868H	测试方法及条件
外观	单组份白色膏状物	
粘度	20000 cP	Brookfield CP51@5rpm, 25 °C
触变指数	3.0	0.5 rpm 粘度/5 rpm 粘度
表干时间	6 min	25°C, 湿度 46%
贮存时间	1 year	25°C
固化条件	EXBOND 1868H	测试方法及概述
推荐固化条件	24h@25°C	
固化后性能	EXBOND 1868H	测试方法及概述
绝缘率	4.22 (100Hz)	Megger
	4.18 (100KHz)	
	5.06 (1MHz)	
导热系数	25°C 2.1Watts permeter K	HotDisk 法
耗散因数	100Hz 0.00783	LCR 测试仪
	100kHz 0.00265	
硬度	80A	邵氏硬度计
延长率	46%	MEGA1500 电子拉力机
剪切强度	25°C 2.9 MPa	Al-Al
	25°C 1.5 MPa	载玻片

上述数据仅可视为产品标准值，不应当作为技术规格使用。

## 使用说明

### 运输

在运输过程中该产品存放于室温环境中即可。

### 拆封

拆开该产品后即可使用，一次用不完，密封后下次可继续使用。

### 贮藏

避免接触大量水汽即可。

### 加工使用

拆封后应当立即放置到点胶机上备用。如果胶需要转移到后一点胶机上，切忌在转移过程中带入杂质以及水汽。该产品必须在推荐的表干时间内使用。详细的使用说明请联系 Bonotec 技术服务部。

### 固化

EXBOND 1868H 胶黏剂全部固化条件建议请查阅 TDS 中的固化条件一栏。

### 包装形式

EXBOND 系列产品可以按照客户的要求装载于针筒或大口瓶中。包装规格包括 1 cc、3cc、5cc、10cc、30 cc、1 盎司、1 磅。详细情况可以参考 Bonotec 标准包装数据或与当地的客户服务代表联系。

本产品对于皮肤敏感的人具有一定的致敏性，应避免皮肤直接接触。若不慎接触，请用肥皂和水冲洗，具体方法详见化学品安全说明书（MSDS, Material Safety Data Sheet）。

### 声明

上述的测量数据仅代表材料本身典型性能，不应当作为技术规格使用。本诺认为这些数据的测量和操作方式是精确的，但不能为其精确性做出保证。

本诺建议用户在使用该产品前根据自己的操作方法和工艺条件判断其是否适合于特定的应用。本诺的工程师也将会帮助用户更好的使用该产品，满足用户应用要求。本诺从未授权任何人免除或改变上述条款。